

01,07

Расчет влияния пластической деформации на эволюцию коэффициентов интенсивности напряжения трещины в ОЦК-кристалле

© Д.Н. Карпинский, С.В. Санников

Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: karp@math.rsu.ru

(Поступила в Редакцию 19 мая 2014 г.

В окончательной редакции 12 сентября 2014 г.)

Выполнены расчеты эволюции коэффициентов интенсивности напряжения при смешанной моде нагружения для различных плоскостей скола, направления фронта трещины и систем легкого скольжения у вершины трещины в ОЦК-кристалле. Расчеты учитывают взаимное влияние пластической деформации и формы вершины трещины, а также T -напряжения. Обнаружена зависимость величины экранирования вершины трещины дислокациями от ориентации трещины, системы легкого скольжения и мод разрушения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00142_a)

1. Введение

Оценка влияния распределения пластической деформации у вершины трещины на характеристики разрушения является актуальной задачей физики прочности и механики разрушения [1]. В частности, эволюция пластической деформации у вершины трещины ответственна за явление вязко-хрупкого перехода в нагруженных образцах [2,3]. Методами механики сплошной среды выполнены многочисленные расчеты форм и размеров пластических зон у вершины трещины в рамках критерия течения Мизеса–Хилла при смешанных модах нагружения для изотропных и анизотропных образцов (см., например, [4–6]), которые были дополнены учетом T -напряжения (см., например, [7–10]). Другое направление исследования пластических зон у вершины трещины методами механики сплошной среды связано с расчетом распределения пластической деформации в окрестности вершины трещины в материале со степенным упрочнением [11,12]. В дальнейшем это направление успешно развивалось в ряде работ (их обзор дан в [13]).

Важно упомянуть о двух методах расчета коэффициентов интенсивности напряжения (КИН) трещины в материалах со степенным упрочнением, учитывающих наличие пластической зоны. Первый метод основан на подходе Эшелби, в котором рассматривают пластическую зону как упругое включение с эффективными модулями [14–16]. Поправки к КИН для мод I и II, учитывающие влияние пластической зоны,

$$K_{I,II}^p = \frac{E}{4\sqrt{2\pi}} \int_A r^{-3/2} \Omega_{I,II}(e_{ij}^T, \theta) dA,$$

где E — модуль Юнга, r — длина радиус-вектора, соединяющего вершину трещины с произвольной точкой

в пластической зоне. $\Omega_{I,II}(e_{ij}^T, \theta)$ — функции деформации превращения e_{ij}^T и полярного угла θ , а интегрирование производится по площади пластической зоны A [15,16]. Для деформационно упрочняющегося материала, который описывается соотношением Рамберга–Осгуда $\varepsilon/\varepsilon_0 = \bar{\alpha}(\sigma/\sigma_0)^n$ ($\bar{\alpha}$ и n постоянные упрочнения, ε , σ — деформация и напряжение при растяжении, σ_0 — предел текучести при растяжении), влияние пластической зоны на КИН приводит к росту экранирования вершины трещины с увеличением n при фиксированном приложенном напряжении, а также с увеличением приложенного напряжения при фиксированном n . Расчеты [15,16] показали, что T — напряжения оказывают опосредованное влияние на КИН (через размер и форму пластической зоны). Важно отметить, что при отрицательном T -напряжении размер пластической зоны увеличивается и экранирование вершины значительно, а при положительном T -напряжении его влияние на КИН мало.

Второй метод расчета пластического КИН использует модельные распределения [11,12] полей напряжения и деформации у вершины трещины [17]. Этот метод расчета определяет КИН смешанных мод, учитывающий влияние пластической зоны как $K^p = \left[\frac{(K_I^2 + K_{II}^2)}{\bar{\alpha}\sigma_0^2 I_n(\theta^*)} \right]^{1/(n+1)}$, где K_I и K_{II} — КИН трещины для мод I и II в отсутствии пластической деформации, θ^* — угол, определяющий направление возможного роста трещины (зависит от выбранного критерия разрушения), величина $I_n(\theta^*)$ определяется численно и монотонно возрастает при переходе от моды II к моде I. Оба метода расчета КИН учитывают T -напряжения у вершины трещины, а также соотношение мод нагружения. Тем не менее, методы расчета КИН [14–17], использующие положения механики сплошной среды, недостаточно точно отражают сложный процесс перестройки структуры у вершины трещины в нагруженном образце.

В последние десятилетия обозначился значительный прогресс в создании дислокационных моделей для пластической деформации у вершины трещины (см., например, [18–23]). В этих работах учтена дискретность систем скольжения в отдельных зернах образцов в противоположность [11–13], где предполагалась непрерывная пластическая деформация (усредненная по многим зернам образца). В [18–23] показано, что упругие поля у вершины трещины в монокристалле существенно отличаются от распределений [11,12] в изотропных пластических телах и зависят от ориентации систем скольжения относительно плоскости трещины.

В настоящее время для расчетов равновесной структуры активно используется метод молекулярной динамики для моделирования взаимодействия трещины с дислокациями, двойниками и другими дефектами в ОЦК-кристаллах (см., например, [24–31]). В частности, в [30] даны оценки критических КИН трещины $K_{I,II}^c$ и $K_{I,II}^d$ при достижении которых начинается рост трещины в ОЦК-железе или эмиссия дислокаций из ее вершины ($K_{I,II}^c \approx K_{I,II}^d \approx 1 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$). Отметим, что расчеты в [24–31] не учитывают эволюцию распределения дислокаций, которые обусловлены источниками, распределенными в кристалле вблизи вершины трещины.

Целью настоящей работы является сравнение эволюции пластической деформации у затупленной вершины трещины в ОЦК-кристалле в условиях смешанной моды нагружения (моды I и II) для различных систем дислокационного скольжения в пластической зоне. В дальнейшем ограничимся расчетами для кристалла α -железа при плоской деформации и внешней нагрузке (моды I и II), при которой отсутствует эмиссия дислокаций и двойников из вершины трещины.

2. Постановка задачи и метод решения

Рассмотрим плоские задачи об эволюции пластической деформации у вершины трещины длиной $2l$, расположенной в плоскостях скола бесконечного ОЦК-кристалла с постоянной решеткой a . В кристалле равномерно распределены источники дислокаций, испускающие прямоугольные петли, лежащие в плоскостях легкого скольжения. В расчете учитываются только отрезки петель, перпендикулярные плоскости Oxy (рис. 1). Рассмотрим следующие кристаллографические ориентации трещины в ОЦК-кристалле [23–31]: 1) плоскость скола (100), направление линии фронта трещины [001]; 2) плоскость скола (110), направление линии фронта трещины [001]; 3) плоскость скола (011), направление линии фронта трещины [0 $\bar{1}$ 1]; 4) плоскость скола (001), направление линии фронта трещины [110]. В этих случаях пластическая деформация осуществляется путем термоактивированного движения дислокации с вектором Бюргерса $\mathbf{b} = a/2\langle 111 \rangle$. Углы между плоскостями скола и системами легкого скольжения $\{111\}$ $\{110\}$ и $\langle 111 \rangle$

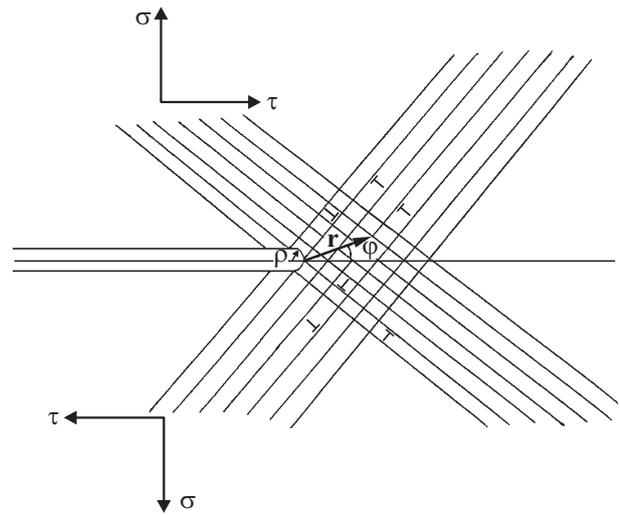


Рис. 1. Кристаллографическая схема плоскостей легкого скольжения у вершины затупленной трещины, нагруженной удаленными растягивающей σ и сдвиговой τ нагрузками.

$\{112\}$ принимают значения: для ориентации 1) 45° , 2) 45° , 3) 54.73° , 4) 35.26° . Линии дислокаций во всех случаях параллельны фронтам трещины, причем для случаев 1)–2) это смешанные дислокации, а для случаев 3)–4) — чисто краевые. В расчетах учитываются только краевые компоненты смешанных дислокаций. Это упрощение связано с видом приложенной нагрузки, действующей только на данные компоненты дислокаций.

К плоскостям кристалла $y = \pm\infty$ приложено однородные напряжения растяжения $\sigma_{yy}(t) = \sigma_a(t)$ (мода I) и сдвига $\tau_{xy}(t) = \tau_a(t)$, (мода II), монотонно возрастающие от $\sigma_a(t=0) = 0$, $\tau_a(t=0) = 0$ до некоторых значений σ_{\max} , τ_{\max} достаточных для пластического деформирования кристалла, но недостаточных для роста трещины, эмиссии дислокаций и двойников из вершины трещины. Согласно [28], это условие можно записать в следующем виде: $K_{\text{eff}} < K_{\text{eff},c}$, где $K_{\text{eff}} = \sqrt{K_I^2 + K_{II}^2}$, $K_{\text{eff},c} = \min(K_{I,II}^c, K_{I,II}^d)$. В расчетах на этапе нагружения выбиралась скорость нагружения $\dot{\sigma}_a(t)$, $\dot{\tau}_a(t)$, которая учитывает ограничение на максимальную скорость сдвиговой деформации в пластической зоне $\max(\dot{\epsilon}(r, t)) \leq 0.1 \text{ с}^{-1}$. Это ограничение соответствует термоактивированному механизму движения дислокаций, который предполагает совместное действие концентрации напряжений у вершины трещины и тепловых флуктуаций дислокаций.

После достижения нагрузками $\sigma_a(t)$ и $\tau_a(t)$ своих максимальных значений расчет проводился в режиме релаксации напряжения у вершины трещины, которому соответствуют постоянные внешние напряжения. Скольжение дислокаций приводит к релаксации напряжения, и вблизи вершины возникают значительные плотности эффективных дислокаций (избыточные дислокации одного знака среди дислокаций с параллельными векторами

Бюргерса) и, следовательно, возникает упругое поле, существенно влияющее на эволюцию пластической деформации. Расчет останавливался в момент времени $t = t_f$, когда максимальное эффективное сдвиговое напряжение в заданной системе скольжения пластической области становилось меньше величины, которую определим ниже (см. (2)).

Рассмотрим процесс вычисления распределения пластической деформации подробнее. Аналогично [32,33], будем предполагать, что скорость пластического деформирования, обусловленного движением дислокаций у вершины трещины, дается формулой

$$\frac{d\varepsilon^k(r, t)}{dt} = \varepsilon_0 \exp \left[-\frac{U_0 \{1 - [\sigma_e^k(r, t)/\tau_0]^{1/2}\}}{k_B T_0(r, t)} \right] \text{sign } \sigma_e^k(r, t), \quad (1)$$

где U_0 — энергия активации, k_B — постоянная Больцмана, T_0 — температура, ε_0 и τ_0 — постоянные, σ_e^k — эффективное напряжение сдвига в k -ой плоскости легкого скольжения

$$\begin{aligned} \sigma_e^k(r, t) &= \sigma^k(r, t) - \sigma_s(r, t) \text{sign } \sigma^k(r, t) \\ &\quad \text{при } |\sigma^k(r, t)| > |\sigma_s(r, t)|; \\ \sigma_e^k(r, t) &= 0 \quad \text{при } |\sigma^k(r, t)| < |\sigma_s(r, t)|. \end{aligned} \quad (2)$$

В (2) сдвиговое напряжение в плоскостях легкого скольжения

$$\sigma^k(r, t) = \sigma_k^c(r, t) + \sigma_k^l(r, t), \quad (3)$$

$$\sigma_s(r, t) = \sigma_T + \sigma_f(r, t), \quad (4)$$

— напряжение, препятствующее пластическому сдвигу за счет трения решетки σ_T и локального упрочнения материала σ_f , вычисляемого по формуле

$$\sigma_f = \sigma_1 \left[\sum_{k=1}^2 |\varepsilon(r, t)| \right]^m, \quad (5)$$

где σ_1 и m — постоянные. В (3) $\sigma_k^c(r, t)$ — сдвиговая компонента тензоров напряжения (2) для k -ой плоскости легкого скольжения, которую вычисляли с учетом T -напряжений: $\sigma_{rr} = \sigma_r + T \cos^2 \varphi$, $\sigma_{\varphi\varphi} = \sigma_\varphi + T \sin^2 \varphi$, $\sigma_{r\varphi} = \tau_{r\varphi} - T \sin \varphi \cos \varphi$, где в данном случае $T = -\sigma_a(t)$. Величины σ_r , σ_φ , $\tau_{r\varphi}$ задают распределения упругого поля трещины в полярных координатах r и φ у вершины хрупкой трещины с учетом ненулевой величины радиуса вершины ρ прямолинейной трещины [34]

$$\begin{aligned} \sigma_r &= \frac{K_I}{4\sqrt{2\pi r}} \left[\phi_1(\rho, r) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \psi_1(\rho, r) \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \right] \\ &\quad - \frac{K_{II}}{4\sqrt{2\pi r}} \left[\phi_1(\rho, r) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \psi_2(\rho, r) \sin\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \right], \\ \sigma_\varphi &= \frac{K_I}{4\sqrt{2\pi r}} \left[\phi_2(\rho, r) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \psi_3(\rho, r) \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \right] \\ &\quad - \frac{K_{II}}{4\sqrt{2\pi r}} \left[\phi_2(\rho, r) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \psi_4(\rho, r) \sin\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau_{r\varphi} &= \frac{K_I}{4\sqrt{2\pi r}} \left[\phi_3(\rho, r) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \psi_5(\rho, r) \sin\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \right] \\ &\quad + \frac{K_{II}}{4\sqrt{2\pi r}} \left[\phi_3(\rho, r) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \psi_6(\rho, r) \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \right], \end{aligned} \quad (6)$$

где

$$\phi_1(\rho, r) = 5 - 2\frac{\rho}{r} - 3\left(\frac{\rho}{r}\right)^2,$$

$$\phi_2(\rho, r) = 3 + 2\frac{\rho}{r} + 3\left(\frac{\rho}{r}\right)^2,$$

$$\phi_3(\rho, r) = 1 + 2\frac{\rho}{r} - 3\left(\frac{\rho}{r}\right)^2,$$

$$\psi_1(\rho, r) = 1 - \frac{7}{2}\frac{\rho}{r} + \frac{5}{2}\left(\frac{\rho}{r}\right)^3,$$

$$\psi_2(\rho, r) = 1 + \frac{1}{2}\frac{\rho}{r} + \frac{5}{2}\left(\frac{\rho}{r}\right)^3,$$

$$\psi_3(\rho, r) = 1 + \frac{3}{2}\frac{\rho}{r} - \frac{5}{2}\left(\frac{\rho}{r}\right)^3,$$

$$\psi_4(\rho, r) = 3 - \frac{21}{2}\frac{\rho}{r} + \frac{15}{2}\left(\frac{\rho}{r}\right)^3,$$

$$\psi_5(\rho, r) = 3 + \frac{3}{2}\frac{\rho}{r} + \frac{15}{2}\left(\frac{\rho}{r}\right)^3,$$

$$\psi_6(\rho, r) = 3 + \frac{9}{2}\frac{\rho}{r} - \frac{15}{2}\left(\frac{\rho}{r}\right)^3.$$

В (6) $K_I = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sigma_\varphi^{\max}}{2} \sqrt{\pi\rho}$ и $K_{II} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \sigma_\varphi^{\max} \sqrt{\pi\rho}$ — КИН эквивалентной трещины, которые обсуждаются в [35]. Расчеты эволюции пластической деформации в данной работе учитывают изменение радиуса кривизны вершины трещины $\rho(t)$ в (6) за счет совместного действия внешней нагрузки и дальнедействующего напряжения, создаваемого распределением эффективных дислокаций у вершины трещины

$$2\rho(t) \approx C \cdot K_I^2, \quad (7)$$

где C — постоянная (см., рис. 6 в [36]).

В расчете принята пропорциональность двух типов внешних нагрузок $\sigma_a(t) = p \cdot \tau_a(t)$, постоянная p является параметром задачи, для которой максимальные величины сдвиговых напряжений $\sigma_{r\varphi}$ соответствуют направлениям легких плоскостей скольжения. В нашем случае кристаллографическим ориентациям 1) и 2) соответствует значение $p = 4.5$; ориентации 3) — $p = 8.05$; ориентации 4) — $p = 2.85$. Выбор значений p обусловлен возможностью расчета эволюции пластической деформации при скольжении дислокаций в одной из кристаллографических ориентаций.

В (3) $\sigma_k^l(r, t)$ — дальнедействующее упругое напряжение, создаваемое дислокациями одного знака в пластической зоне

$$\sigma_k^l(r, t) = \sum_{k=1}^2 \int_{D_k} \tilde{\sigma}_k(z') \Delta \rho_k(z') dz', \quad z' = x' + iy', \quad (8)$$

где D_k — часть пластической зоны, образовавшейся в верхней полуплоскости в результате скольжения дислокаций вдоль направления векторов ξ_k сопряженных систем легкого скольжения ($k = 1, 2$). В (8) $\Delta \rho_k(z', t)$ — плотность эффективных дислокаций, связанных с деформацией сдвига $\varepsilon^k(r, t)$ соотношением [37]

$$\Delta \rho_k(r, t) = -\frac{1}{b} \frac{d}{d\xi_k} \varepsilon^k(r, t), \quad (9)$$

а $\tilde{\sigma}_k(z')$ определяет напряжение, создаваемое дислокацией в упругой плоскости с полубесконечным разрезом, и задается выражением

$$\tilde{\sigma}_k(r, r') = \sigma_k'(r, r') + \sigma_k''(r, r'), \quad (10)$$

где $\sigma_k'(r, r')$ — компоненты тензора, которые характеризуют собственное поле пары дислокаций, а компоненты тензора $\sigma_k''(r, r')$ описывают поле напряжений полубесконечной трещины — разреза, нагруженной на ее берегах усилиями, равными по величине и противоположными по знаку усилиям, создаваемым в сплошном кристалле напряжениями $\sigma_k'(r, r')$ на месте трещины. Уравнения (1)–(10) образуют систему, из которой при начальных условиях

$$\varepsilon_k(r, t = 0) = 0, \quad \sigma^k(r, t = 0) = 0 \quad (11)$$

и граничных условиях

$$\sigma_e^k(x \leq 0, y = 0, t) = 0 \quad (12)$$

методом конечных разностей определяются $\varepsilon^k(r, t)$, $\sigma_e^k(r, t)$.

С целью повышения достоверности расчета размер ячеек сетки вблизи вершины трещины ($r \leq 2\mu\text{m}$) выбирался (в отличие от [33]) в два раза меньшим по сравнению с сеткой на удаленных участках. В расчетах задавались не σ_{max} и τ_{max} , а соответствующие значения максимального КИН K_I^{max} и $K_{II}^{\text{max}} = K_I^{\text{max}}/p$. Для расчетов эволюции пластической деформации в кристалле $\alpha\text{-Fe}$ были выбраны следующие значения постоянных: $2l = 10^{-3} \text{ m}$, $K_I^{\text{max}} = 0.2 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2} < \min(K_{I,II}^c, K_{I,II}^d)$, $T_0 = 300 \text{ K}$; модуль сдвига $\mu = 86.4 \text{ GPa}$, коэффициент Пуассона $\nu = 0.29$, $a = 2.867 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, $\varepsilon_0 = 10^{11} \text{ s}^{-1}$, $U_0 = 0.9 \text{ eV}$, $\tau_0 = 330 \text{ MPa}$, $\sigma_0 = 18 \text{ MPa}$, $\sigma_1 = 2 \text{ GPa}$, $m = 1$ [32,33]. На основе результатов расчета эволюции пластической деформации далее была вычислена эволюция КИН. В расчете предполагалось, что для КИН трещины имеет место представление [38]

$$K_I(t) = K_I^b(t) + \text{Re}[K^p(t)], \quad K_{II}(t) = K_{II}^b(t) + \text{Im}[K^p(t)], \quad (13)$$

где $K_I^b(t) = \sigma_a(t)\sqrt{\pi l}$, $K_{II}^b(t) = \tau_a(t)\sqrt{\pi l}$ — КИН хрупкой трещины. Величина $K^p(t)$ определяет поправку, которая

учитывает влияние пластической деформации на КИН

$$K^p(t) = \sum_{k=1}^2 \int_{D_k} \tilde{K}_k^p(z') \Delta \rho_k(z', t) dz', \quad z' = x' + iy', \quad (14)$$

где \tilde{K}_k^p — КИН трещины, соответствующий действию одной дислокации, вычисляется по формуле [39]

$$\tilde{K}_{Ik}^p - i\tilde{K}_{IIk}^p = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^0 [p_2(\xi) - ip_1(\xi)] \frac{d\xi}{\sqrt{-\xi}}. \quad (15)$$

В (15) предполагается, что на берегах полубесконечной прямолинейной трещины заданы нормальные p_2 и касательные p_1 напряжения, создаваемые дислокацией на k -ой плоскости скольжения. Отметим, что знаки $K_I(t)$ и $K_{II}(t)$ в (13) зависят от абсолютной величины и знака слагаемых.

3. Результаты расчетов и их обсуждение

В настоящей работе предложена математическая модель эволюции пластической деформации, которая учитывает временную зависимость радиуса кривизны (7), измельчение ячеек сетки вблизи вершины трещины и специальные соотношения между компонентами мод при смешанном нагружении. Выбор этих соотношений позволяет выделять при расчете различные системы легкого скольжения. Результаты расчетов распределения пластической деформации и КИН при указанных дополнениях подтвердили выводы [33], о том что „дислокационный заряд“ у вершины трещины в ОЦК кристалле создает дальнедействующее упругое поле и вносит существенный вклад в эволюцию пластической зоны. Подтвердилось также, что затупление трещины и T -напряжения приводят к укорочению времени t_f достижения равновесного распределения пластической деформации у вершины трещины в кристалле. Величина t_f зависит также от ориентации трещины и системы скольжения. Так, например, t_f для варианта 3 больше, чем для варианта 4 и существенно больше, чем для вариантов 1, 2, что соответствует более быстрому процессу релаксации эффективного сдвигового напряжения у вершины трещины по плоскостям скольжения, расположенных под меньшим углом к плоскости трещины. Среди других результатов расчета следует отметить зависимость величины экранирования вершины трещины дислокациями от ориентации трещины, системы легкого скольжения и мод разрушения. На рис. 2–4 показаны временные зависимости КИН для мод I и II (см. подписи к рисункам). Из этих рисунков видно, что процесс релаксации $K_I(t)$ протекает почти одинаково для всех вариантов расчета, хотя для варианта 3 (рис. 4) этот процесс более глубокий. Сложнее протекает процесс релаксации $K_{II}(t)$. Так для варианта 3 (рис. 4) $K_{II}(t)$ снижается до нуля менее, чем за 1с, а для вариантов 1, 2 (рис. 3) при $t > 1\text{ s}$

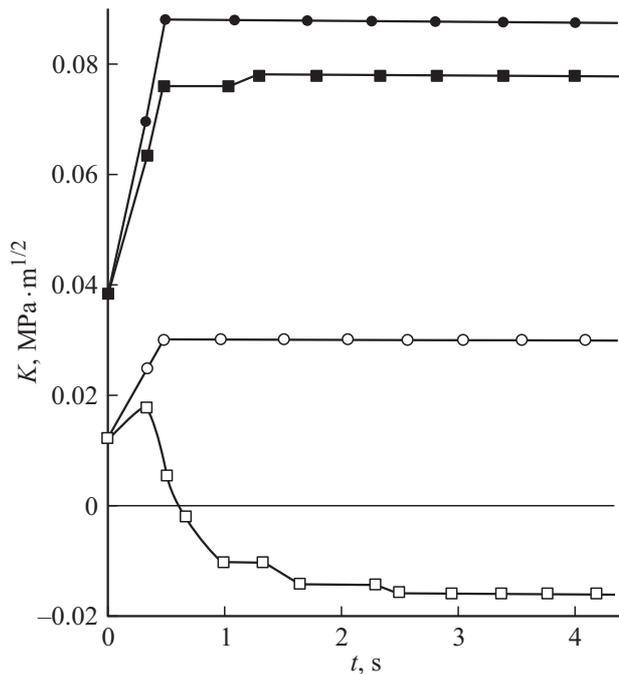


Рис. 2. Временная зависимость коэффициентов интенсивности напряжения. Кривые, отмеченные темными и светлыми кругами, определяют эволюцию КИН без учета пластической деформации, а отмеченные темными и светлыми квадратами — с учетом влияния пластической деформации для мод I и II соответственно. Ориентации плоскости трещины, ее линии фронта и системы легкого скольжения соответствуют кристаллографическому варианту 4 (см. текст).

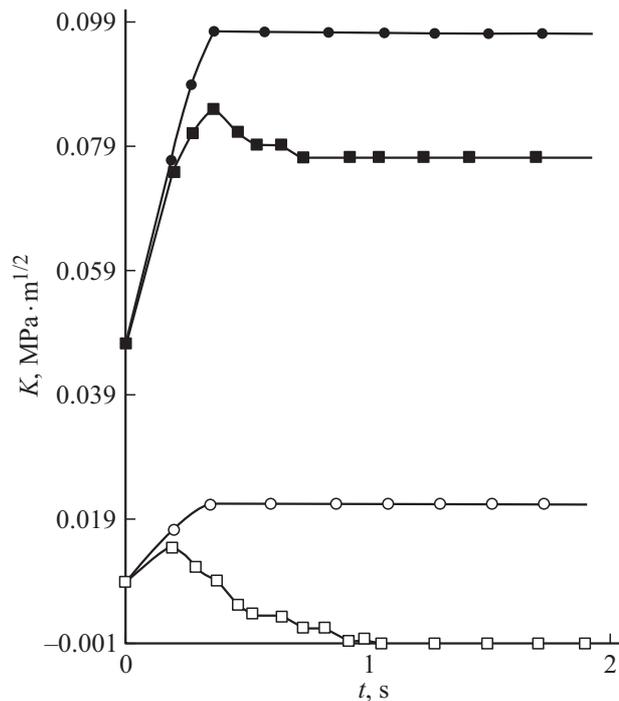


Рис. 3. То же, что на рис. 2, но для вариантов 1 и 2 (см. текст).

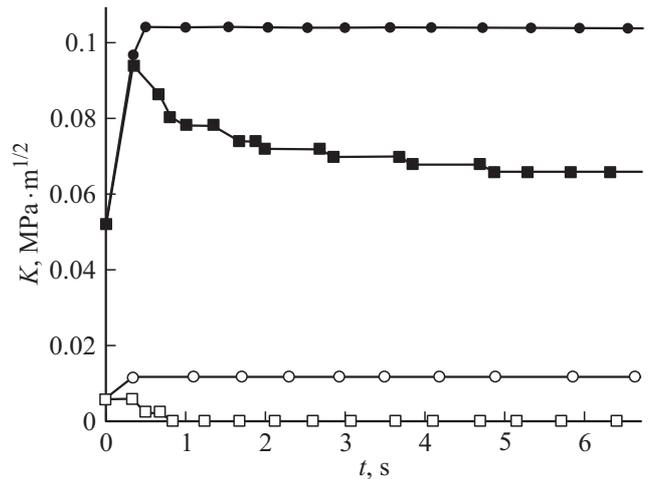


Рис. 4. То же, что на рис. 2, 3, но для варианта 3 (см. текст).

величина $K_{II}(t)$ принимает постоянное отрицательное значение. Отметим, что для варианта 4 (рис. 2) при $t > 2$ s $K_{II}(t)$ также принимает постоянное отрицательное значение, но значительно большее по абсолютной величине, чем для вариантов 1, 2. Физический смысл отрицательного значения $K_{II}(t)$ при $t \geq 1$ s связан с превышением сдвигового напряжения (8), создаваемого скоплением дислокаций у вершины трещины, над напряжением сдвига $\sigma_k^c(r, t)$, обусловленного внешней нагрузкой, а это приводит к смене знака p_1 в (15). Следует также упомянуть, что аналогичный расчет в [33] не показал отрицательных значений $K_{II}(t)$. Использование в данной работе мелкой вычислительной сетки у вершины трещины позволило обнаружить новые особенности во временной зависимости КИН.

Заключение

Процесс релаксации напряжения у вершины трещины обусловлен экранированием вершины дислокациями. Затупление трещины и T -напряжение также заметно влияют на равновесное распределение пластической деформации у вершины трещины и временные зависимости КИН. Обнаружена зависимость процесса релаксации напряжения у вершины трещины от взаимной ориентации плоскости скола, линии фронта трещины и плоскостей легкого скольжения дислокаций. Обнаружено, что при некоторых ориентациях дислокационный вклад в КИН моды II превышает КИН, обусловленный внешней нагрузкой.

Список литературы

- [1] R. Narasimhan, H.Y. Subramanya, S.D. Patil, P. Tandaiya, U. Ramamurty. *J. Phys. D* **42**, 214 005 (2009).
- [2] M. Tanaka, E. Tarleton, S.G. Roberts. *Acta Mater.* **56**, 5123 (2008).

- [3] T. Smida, V. Magula. *Mater. Design* **54**, 582 (2014).
- [4] G. Xin, W. Hangong, K. Xingwu, J. Liangzhou. *Eur. J. Mech. A/Solids*. **29**, 738 (2010).
- [5] M.R. Ayatollahi, K. Sedighiani. *Struct. Eng. Mech.* **36**, 575 (2010).
- [6] F. Caputo, G. Lamanna, A. Soprano. *Eng. Fract. Mech.* **103**, 162 (2013).
- [7] Q. Nazarali, X. Wang. *Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct.* **34**, 792 (2011).
- [8] Ю.Г. Матвиенко, Р.А. Починков. *Деформация и разрушение материалов* **3**, 6 (2012).
- [9] R.A. Sousa, J.T.P. Castro, A.A.O. Lopes., L.F. Martha. *Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct.* **36**, 25 (2012).
- [10] V.N. Shlyannikov. *Eng. Fract. Mech.* **99**, 3 (2013).
- [11] J.R. Rice, G.F. Rosengren. *J. Mech. Phys. Solids* **16**, 1 (1968).
- [12] J.W. Hutchinson. *J. Mech. Phys. Solids* **16**, 13 (1968).
- [13] Л.В. Степанова. *Математические методы механики разрушения*. Физматлит, М. (2009). 336 с.
- [14] Z. Li, J. Duan. *Int. J. Fract.* **117**, L29 (2002).
- [15] P. Zhu, L. Yang, Z. Li, J. Sun. *Int. J. Fract.* **161**, 131 (2010).
- [16] R. Zhou, P. Zhu, Z. Li. *Int. J. Fract.* **171**, 195 (2011).
- [17] V. Shlyannikov, A. Tumanov. *Int. J. Fract.* **185**, 49 (2014).
- [18] E. Van der Giessen, A. Needleman. *Mod. Simul. Mater. Sci. Eng.* **3**, 689 (1995).
- [19] H.H.M. Cleveringa, E. Van der Giessen, A. Needleman. *J. Mech. Phys. Solids* **48**, 1133 (2000).
- [20] E. Van der Giessen, V.S. Deshpande, H.H.M. Cleveringa, A. Needleman. *J. Mech. Phys. Solids* **49**, 2133 (2001).
- [21] Y.-F. Guo, D.-L. Ghao. *Mater. Sci. Eng. A* **448**, 281 (2007).
- [22] S.S. Chakravarthy, W.A. Curtin. *Mod. Simul. Mater. Sci. Eng.* **19**, 045009 (2011).
- [23] S.S. Shishvan, E. Van der Giessen. *Mod. Simul. Mater. Sci. Eng.* **21**, 065007 (2013).
- [24] V. Shastry, D. Farcas. *Mod. Simul. Mater. Sci. Eng.* **4**, 473 (1996).
- [25] P.A. Gordon, T. Neeraj, J. Luton, D. Farcas. *Metallurgical Mater. transactions A* **38**, 2191 (2007).
- [26] A. Spielmannova, A. Machova, P. Hora. *Acta Mater.* **57**, 4065 (2009).
- [27] I.R. Vatne, E. Østby, C. Thaulow. *Mod. Simul. Mater. Sci. Eng.* **19**, 085006 (2011).
- [28] C.H. Ersland, C. Thaulow, I.R. Vatne, E. Østby. *Eng. Fract. Mech.* **79**, 180 (2012).
- [29] C.H. Ersland, I.R. Vatne, C. Thaulow. *Mod. Simul. Mater. Sci. Eng.* **20**, 075004 (2012).
- [30] I.R. Vatne, A. Stukowski, C. Thaulow, E. Østby, J. Marian. *Mater. Sci. Eng. A* **560**, 306 (2013).
- [31] D. Farkas. *Current Opinion Solid State Mater. Sci.* **17**, 284 (2013).
- [32] W.A. Spitzig. *Acta Metallurgica* **18**, 1275 (1970).
- [33] Д.Н. Карпинский, С.В. Санников. *Завод. лаб. Диагностика материалов* **78**, 52 (2012).
- [34] G. Kulmer, H.A. Richard. *Arch. Appl. Mech.* **76**, 711 (2006).
- [35] P. Livieri, F. Segala. *Eng. Fract. Mech.* **81**, 110 (2012).
- [36] A. Stoll, A.J. Wilkinson. *Int. J. Fract.* **164**, 103 (2010).
- [37] E. Kroner. *Kontinuumtheorie der Versetzungen und Eigenspannungen*. Springer-Verlag, Berlin (1958). 198 p.
- [38] Д.Н. Карпинский, С.В. Санников. *Письма в ЖТФ* **11**, 1481 (1985).